

第 23 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時：平成 30 年 9 月 5 日(水) 10:30～16:25

場所：大阪大学 吹田キャンパス 岡田メモリアルホール(工学部内 R1 棟3階 312)

時間	題 目	講 演 者
	司会 井上雅博 (群馬大学)	
10:30～ 12:00	『“セルロースナノファイバー”の電子デバイス 応用』 (45 分)	○能木雅也 (大阪大学)
	『フレキシブル基板に低ダメージなデバイス 製造技術・実装技術の開発』 (45 分)	○植村 聖、金澤賢司、渡邊雄一、 中村考志、西岡将輝 (産業技術総合研 究所)
12:00～ 13:10	昼 食 休 憩	
13:10～ 13:20	委 員 会 議 事	
	司会 山中公博 (中京大学)	
13:20～ 14:50	『3D-MID対応の実装システムの開発』 (45 分)	○川北嘉洋、塚原法人、三宅貴大 (パナソニック(株))
	『金属塩の生成・分解反応を用いた電子 デバイスの低温接合に関する検討』 (45 分)	○小山真司 (群馬大学)
14:50～ 15:00	休 憩	
	司会 青島正貴 (トヨタ自動車(株))	
15:00～ 16:25	『車載用パワー半導体モジュールにおける 高信頼接合技術』 (45 分)	○両角 朗 (富士電機(株))
	『インフィニオン製車載用両面放熱パワー モジュール HybridPACK™DSC』 (40分)	○竹谷英一 (インフィニオンテクノロ ジーズジャパン(株))

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。